

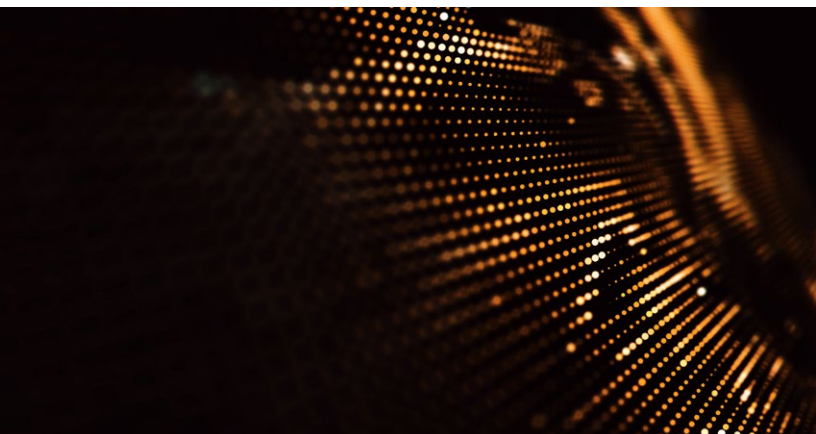
# FORMAPad<sup>®</sup> 418

PAD Térmico do tipo  
'Form-in-Place'



## Descrição

O FORMAPad 418 é uma pasta mono-componente ultra macia e conformável, utilizada como elemento de gerenciamento térmico na indústria eletrônica. Sua consistência aderente e ultra macia garante uma transferência de calor altamente eficiente entre componentes frágeis e que não toleram altos níveis de pressão mecânica em sua fixação. O FORMAPad foi desenvolvido para atender às crescentes demandas de gerenciamento térmico de componentes eletrônicos de alta potência nominal e alta densidade de potência. O FORMAPad 418 tem excelente adesão a vários tipos de superfície, diferentes geometrias e tamanhos de componentes e por não conter silicone em sua formulação, não apresenta risco de contaminação em dispositivos delicados. Pode ser aplicada como uma pasta térmica, mas não apresenta as falhas associadas a esse tipo de produto, já que não sangra, não resseca e não tem seu desempenho térmico degradado ao longo da vida útil do produto, a exemplo do que acontece com as pastas térmicas.



# FORMAPad® 418

**CELERA**  
Passion for Technique

## Propriedades Típicas

| Propriedade               | Unidade           | Valores                                |
|---------------------------|-------------------|--|
| Tipo                      | -                 | mono-componente,<br>isento de silicone |
| Cor                       | -                 | Branco                                 |
| Viscosidade               | PaS               | 4500                                   |
| Densidade                 | g/cm <sup>3</sup> | 2,7                                    |
| Condutividade Térmica     | W/m.k             | 2,0                                    |
| Resistência Térmica       | °C                | -55 to 200                             |
| Validade                  |                   | 5 anos                                 |
| Resistência Dielétrica    | kV/mm             | 16,0                                   |
| Fator de Dissipação       | KHz               | 0,003                                  |
| Resistividade Volumétrica | Ohm.cm            | 10 <sup>14</sup>                       |



### Características

- Condutividade Térmica de 2,0W/mk
- Macio e conformável não impondo stress mecânico a componentes eletrônicos frágeis
- Isento de silicone
- Não apresenta degradação de seu desempenho ao longo dos ciclos térmicos da aplicação



### Aplicações

- Interface térmica em semicondutores que requerem baixa força mecânica de montagem
- Chips do tipo PPGA, BGA, Micro BGA, DSP
- COBs e LEDs SMD de alta potência



### Formatos

- Seringas de 30ml
- Bisnagas de 300ml
- Potes de 1,0kg